

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	天风证券、山西证券、华西证券、财通证券、厦门国贸等 6 名投资者
时间	2023 年 11 月 3 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：彭民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动主要问题及回答如下：</p> <p>1、光伏行业一直有技术创新，公司是否有相应准备？</p> <p>答：公司始终聚焦核心技术能力，以先进配方化材料技术平台为依托，在玻璃粉技术、高温烧结技术、低温固化/烧结技术、超细线图形印刷技术等方面具有核心优势与竞争力。通过十来年的自主研发与创新实践，帝科现已成长为全球领先的光伏金属化浆料供应商之一，针对行业持续技术创新与不同技术类型都有前瞻性技术研究与相应产品研发储备。公司始终坚持高度重视研发持续投入，持续培养和引进高素质的研发人员，拥有一支多元化、国际化的研发技术团队，并不断扩充强化，对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，在产品迭代升级频率、技术服务强度上均处于领先优势。</p> <p>2、公司 TOPCon 正面和背面银浆市占率是否有差异？</p>

答：TOPCon 电池是双面结构且对导电银浆存在差异化需求，TOPCon 电池正、背面全套金属化浆料产品包括正面硼扩散发射极接触用银铝浆、背面掺杂多晶硅层接触用银浆及正背面主栅银浆，对于浆料有更高的技术要求，有着更高的技术难度。目前，公司 TOPCon 银浆产品中背面银浆市占率要高于正面银浆，TOPCon 全套导电银浆产品总体市占率处于行业领先。

3、了解下公司前三季度 TOPCon 银浆加工费与单瓦用量变动情况？

答：公司 TOPCon 银浆的加工费与单瓦用量在 1-3 季度相对稳定，变化不大。

4、如何看待 TOPCon 银浆的进入门槛，未来新进入者多吗？

答：整体来看，TOPCon 银浆的护城河是增高的，相比 PERC，行业集中度会进一步提升，行业格局也会更稳定，主要原因有以下四点：（1）TOPCon 电池是双面结构且对导电银浆存在差异化需求，技术难度高于 PERC，涉及到多学科的材料技术，需要足够的技术沉淀和研发实力，具有很强的技术壁垒；（2）导电银浆直接关系到电池片的转换效率，下游客户会对 TOPCon 银浆进行多维度、长周期的测试认证，准入门槛较高；（3）银浆行业对原材料采购、研发支出的投入要求在逐步提升，新进入者会面临巨大的资金压力；（4）银浆行业是一个需要对产品持续投入、不断迭代升级的行业，运行过程中需要足够的技术研发人才来同步配合，人才壁垒也是非常高的。

5、激光辅助烧结技术是否会影响现有 TOPCon 银浆竞争格局？

答：随着激光辅助烧结技术等新技术的迭代与应用，TOPCon 银浆的技术壁垒会不断提升，对应龙头企业的领先与先发优势都会越来越明显。目前，公司在激光辅助烧结工艺专

用导电浆料产品上处于行业领先地位，正积极与行业领先客户不断协同创新，共同推进相关技术及产品的快速大规模量产。

6、公司银浆产品的库存情况如何？

答：导电银浆属于定制化产品，公司实行以销定产的生产模式并自行生产，库存周期较短，公司银浆产品的库存处于低位。

7、公司建设硝酸银项目的目的？

答：硝酸银产品的纯度对于金属粉体的性能与成本有重要影响，公司投资建设硝酸银项目可以极大程度地保障供应链安全性与稳定性，并有利于降低原材料成本，提高公司产品竞争力。

8、公司不断推进国产银粉替代，对公司有什么影响？

答：进口银粉主要参考伦敦银点价格，国产银粉主要参考国内银点价格，正常情况下国产银粉的价格相对低于进口银粉，具体价差随着银点和汇率波动而波动。随着国产粉使用比例的提升，可以进一步改善公司的毛利，降低汇率波动对公司产生的影响。

9、请介绍一下公司异质结的进展情况。

答：异质结方面，公司在低温纯银浆料路线和银包铜路线是持续双线推进发力，已在多家行业头部企业完成了产品认证，产品性能指标处于行业领先水平。低温纯银浆料长期处于稳定供货交付阶段，低温银包铜浆料在行业龙头客户处已经实现稳定批量供货。

10、公司半导体浆料未来的进展和后续放量的节奏？

答：公司布局的非光伏业务主要聚焦在半导体电子领域，主要分为三个方向的产品：一是 LED 与 IC 芯片封装粘接银浆在不同导热系数场景的应用；二是面向第三代功率半导体芯片封装粘接的烧结银产品，在超高散热场景的应用，是未来功率半导体发展的关键材料之一；三是功率半导体封装用 AMB 陶

	<p>瓷覆铜板钎焊浆料。与光伏银浆相比，半导体封装浆料品类较多，导入验证的节奏和时间较长。公司将围绕这三大方向持续进行产品完善和迭代，客户群体现处于从小规模的验证客户向中等体量的客户切换过渡阶段，未来公司将重点培育、持续推进，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月3日